

HXMT 中能 X 射线望远镜

曹学蕾 姜维春 张万昌 孟 斌 维 涛 杨 生 张春雷 顾煜栋 孙 亮 刘晓静 李 鲜 杨家卫 谭 颖 刘少真 杜园园

(中国科学院高能物理研究所 100049)

1. 引言

我们通常把波长很短,介于 $0.01 \sim 100$ 埃(能量 0.1keV ~ 1 MeV)之间的电磁辐射,称为 X 射线。 在整个 X 射线波段里,根据探测方法的不同,我们又 模糊的分成了低能 X 射线(能量 $0.1 \sim 10$ keV),中 能 X 射线(能量 $5 \sim 70$ keV),高能 X 射线(能量 20keV ~ 1 MeV)。三个能段没有明显的界限,彼此 相互搭接在一起。

探测 X 射线波段的探测器,即为 X 射线探测器。 根据三个能段的特点,其相应的 X 射线探测器多采用 不同的技术实现。其中,中能 X 射线探测器,主要有 基体厚度在 500μm 以上的全耗尽 Si-PIN 探测器,硅 微条探测器 SSD,硅漂移室探测器 SDD,以及厚度在 0.5~2mm之间的碲锌镉 CZT 探测器等。早期的空间 X 射线探测,气体探测器也被用于中能段的 X 射线探 测,比如 RXTE 卫星采用了 8000cm² 的气体探测器 (能 区 2~60 keV)。

在硬 X 射线望远镜 HXMT 中能 X 射线望远镜(简称 ME) 仪器上,我们便采用了厚度为 1mm 的全耗尽 Si-PIN 探测器。ME 是 HXMT 的三个主要仪器之一,它的主要功能即为中能段 5~30keV 能区的巡天观测,以及针对部分感兴趣且可能会有物理学产出的特定源的定点观测。

2. ME 的主要科学目标

中能 X 射线望远镜 ME 的主要科学目标为:1) 对巡天观测中 HXMT 探测到天体源(黑洞、中子星等) 的中能 X 射线波段的性质(天体源的位置定位,能段 范围,能段范围内的亮度)给出限定;2)在对特定 天体源的定点观测中,给出中能X射线波段的能谱(单位时间内每个能量点的X射线计数)以及时变(该能段计数率随时间的变化情况)信息。

由于天体源 X 射线产生机制的不同,在不同能段 的计数率是不同的。基于 HXMT 三个科学仪器,低 能 X 射线望远镜 LE (1~15keV,384cm²)、中能 X 射线望远镜 ME (5~30keV,952cm²)、高能 X 射 线望远镜 HE (20~250keV,5000cm²),对不同天 体源的观测,在相同的时间段内,低能段很容易发现 到的源在中、高能段也许会由于计数率低,而无法准 确地看到。同样的对某些天体源在某个时间段内 ME 可以看到的,LE 和 HE 也可能无法达到足够的光子数 而不能给出准确的信息。而通过三种仪器联合观测, 不管是哪个仪器发现的天体源,另外两个仪器都可以 对新发现的天体源同时进行长时间的观测,对天体源 的全能段性质进行研究。

3. 设计与研制

根据空间环境的可靠性要求和可维修性的约束, 以及安装约束条件等,ME分成了三个全同的探测器 机箱。每个探测器机箱按照功能又可以分为,准直器, 探测器,电子学三个组成部分。

探测器机箱主要的功能是实现 X 射线的探测,并 将探测到的 X 射线信息传输到中能电控箱。这其中的 信息就包括了入射 X 射线的方向,光子的能量,流强, 以及光子到达时间等。经过电子学系统的处理,将这 些入射光子的信息按照一定的格式组合,形成科学事 例数据。这些信息也就是我们所说的科学数据。探测 器机箱所产生的科学数据,会按照一种约定的接口协 议(ME采用的是 LVDS 接口协议)传送到中能电控箱。



除科学数据外,探测器机箱还产生一部分工程数据, 这包括了探测器的工作温度,电子学系统的监测电压、 电流等信息。工程数据也会通过 LVDS 接口传输到中 能电控箱。

中能电控箱主要功能就是接收探测器机箱的科学 数据与工程数,并将数据按照一定的格式组合成数据 包。然后,根据中能望远镜与卫星之间约定的通讯接 口协议(科学数据通过LVDS接口协议,工程数据通 过1553B接口协议),将数据传输到卫星系统,最终 通过卫星系统传输回地面接收站。同时,中能电控箱 还要接收来自卫星系统的遥控指令,并根据遥控指令 的功能与性质,或者在电控箱执行(比如切换主份与 备份电源),或者通过 LVDS 接口发送给探测器机箱 完成相应的功能(比如调整探测阈值,打开/关闭通 道等)。

3.1 视场与准直器

HXMT 卫星采用准直扫描的方式,来实现天体源 的定位与成像。这其中起关键作用的功能模块即是准 直器,它的功能是限制探测器的视场。对于视场内的 辐射(X射线,带电粒子)会通过准直器后直接作用 于探测器上。非视场内的辐射,会被准直器屏蔽吸收, 同时会有部分次级粒子产生(X射线,电子等)。这 部分打在准直器侧壁上产生的次级粒子也是 ME 的本 底来源的一部分。

中能望远镜采用了组合视场的设计,通过准直器孔径的构造不同,实现三种视场组合的设计方案, 三种视场分别为:1°×4°,4°×4°,以及全遮挡视场。 采用组合视场的设计方案,主要目的是用于在轨观测时的本底估计。在5~30 keV的中能段,要观测的 天体源其X射线的流强非常弱。即使按照高能天文 领域所熟知X射线天体源Crab(中子星),中能望远镜接收到的光子数也只有~1000个/秒,平均到 每个通道只有0.5个/秒。而中能望远镜所观测的多



图 2 中能 X 射线望远镜功能连接示意图





数目标其 X 射线的流强要比 Crab 源弱 1 ~ 2 个数量 级。根据已经在轨运行的 X 射线天文卫星的观测数 据,HXMT 卫星所处的轨道,既有宇宙弥漫光子本 底(各向同性),又有粒子本底。中能望远镜的粒子 本底是高能带电粒子(电子、质子等)穿过探测器时, 与探测器物质发生相互作用,损失其部分或全部能 量,且其损失的能量恰好在中能区 5 ~ 30 keV,便 会形成粒子本底。又或者高能带电粒子与中能望远 镜本身的物质材料(比如,准直器材料,入射窗材料) 发生相互作用,产生次级 X 射线或带电粒子。这些 次级粒子的能量恰好在中能区,且被探测器接收, 也会形成次级粒子本底。如果本底不能有效的扣除, 则仪器的灵敏度会有明显的下降。

三种不同视场组合的设计方案,可以有效的估计 在轨观测的本底。其中全遮挡视场准直器采用钽片遮 挡视场,会屏蔽掉天体源与宇宙弥漫光子,因此可以 估计出仪器的粒子本底。利用大小视场的组合,根据 不同视场对应的探测模块采集到的流强的不同可以估 计出视场内天体源的强度信息。根据估计出的粒子本 底、和天体源强度信息,便可以计算出宇宙弥漫光子 的流强。

根据 ME 视场组合的要求,也考虑准直器加工工 艺的约束条件,ME 准直器的研制最终采用铝合金外 框内部对插钽片的技术方案。采用该设计,准直孔完 全由钽片构成,最大限度上满足了物理学的要求,即 尽量获得大的占空比。在该产品的研制过程中,解决 了包括高精度钽片插槽加工,超薄钽片(75μm)对插, 激光点焊等相关技术难题。

3.2 Si-PIN 探测器与探测原理

中能望远镜的探测器采用的是面阵型 Si-PIN 探测器。该探测器的器件结构可以等效为一个 PN 结,其 典型的 Si-PIN 探测器结构如图 5 所示,其基本的工艺 为使用高纯硅片作为基体,通过离子注入的方式,在 探测器内部分别形成 P 型和 N 型掺杂区,在其高阻本 征区形成一个 PN 结,即探测器的基本功能结构单元。 其中离子注入工艺是将离子源(轰击靶材,电离原子) 产生的目标掺入杂质(B、P等),通过静电场的加速 获得足够的能量(几万到几十万 eV)注入到半导体材 料表面一定深度。同时为了减少表面漏电对探测器的



图 4 ME 准直器视场组合设计图





性能影响,在探测器的边缘部分设计有保护环的结构。

在 ME Si-PIN 探测器的设计中将两像元的 Si-PIN 探测器设计在一片硅片上,同时将两片两像元的 Si-PIN 探测器封装在一个陶瓷外壳中,构成 ME 最终使 用的 Si-PIN 探测器产品。单个探测器像元的灵敏区尺 寸为12.5mm×4.5mm,即面积为56.25mm²,探测器 的厚度为1mm。

对于进入 ME 视场内的 X 射线, 在穿透入射窗 之后,会进入探测器内。探测器的入射窗采用的是50 微米厚的薄铍片, 它的主要作用是遮挡可见光, 并且 隔离灰尘避免探测器表面受到污染。

1) 探测原理

X射线光子进入到 Si-PIN 探测器灵敏区,与灵敏 区硅介质发生相互作用,对于5~30 keV 能区的X 射线光子来说,与硅材料的相互作用,主要为光电效 应与康普顿效应。入射X射线光子将自身能量的全部 (光电效应)或者部分(康普顿效应)转移给硅物质 材料中的内层电子,内层电子在吸收光子能量后,摆 脱硅原子核的束缚,成为自由电子,在这个过程中产

入射光子

生的电子也称为光电子。光电子带有入射光子的部分 能量,在探测器内运动。而带电粒子在物质中运动时 会发生电离效应。即:带电粒子在物质中运动时,经 过原子附近时,原子的外层电子受到光电子的库伦力 作用,从而发生电离而脱离原子核的束缚,成为自由 电子。失去外层电子的原子核则带一个正电荷,被称 为空穴。Si-PIN 探测器的两极之间会外接偏置电压, 在其内部形成电场, 而光电子在探测器中电离所产生 的电子与空穴会在电场的作用下向两极移动,最终到 达两极而被收集。X射线光子入射到探测器后,经过 X射线光子与探测器介质的相互作用,最终产生的电 子 - 空穴对数目的平均值 N 正比于入射 X 射线光子 能量 E。通过电子学系统,将探测器两极收集到的电 荷数便可以得到入射 X 射线光子的能量信息。

在这个物理过程中,由于探测器中的硅原子内层 电子被激发后脱离原子核的束缚,原子核失去内层电 子后, 便会处于一种不稳定状态。外层电子会跃迁到 内层上,在这个跃迁过程中所释放的能量会转移给外 层电子使其电离成为俄歇电子,或者会产生一个 X 射





线荧光光子。而 X 射线荧光光子如果从探测器基体逃逸出去,那么这个物理过程就会损失掉一部分能量。 荧光光子产生的概率非常低,当有大量 X 射线光子入 射到探测器时,相应地从探测器加读出电子学系统中 会得到一部分能量低于正常值(低 1.74keV,即硅的 K 系荧光线能量)的 X 射线光子事例,从而在观测结 果的能谱中会出现一个结构,被称为逃逸峰。

2) Si-PIN 探测器的优缺点

ME 所使用的 Si-PIN 探测器,厚度在 1mm,外加偏置高压在 170V,在 X 射线光子与探测器材料发生相互作用后所产生的空间电荷(电子与空穴)收集时间小于 1µs,所以该探测器具有非常快的响应时间。相比于 CZT 探测器和闪烁体探测器,Si-PIN 探测器具有硅探测器所共有的更好的本征能量分辨率。而相对于 X-CCD,由于其采用点对点的读出方式,即:每个探测器像元都对应着独立的读出电子学通道,因此系统的死时间(电子学系统处理一个光子信号的时间)会小一个数量级以上。同时,相比于硅锂探测器和高纯锗探测器液氮工作温度(77K)来说,Si-PIN 探测器只需要工作在 253K 左右的温度即可,在空间使用热设计上会更容易实现。

ME 所使用的 Si-PIN 探测器为完全国内自主研制 的探测器。从 Si-PIN 半导体工艺,到封装,筛选试 验,鉴定试验,全部在国内完成。而由于 ME 所使用 的 Si-PIN 探测器的工艺特点,其表面易受水汽(主 要影响物为水汽中的杂质)、以及其他污染气体的影 响,极易发生表面污染。而污染一旦发生,由于探测 器外加 170V 偏压,会在探测器表面产生正常值(< 30nA@25℃) 十倍以上的表面漏电流增加,从而会大 大影响探测器的性能指标。因此,对全过程的防污染 控制有非常高的要求。

3.3 读出电子学

读出电子学的主要功能是处理探测器收集到的入 射 X 射线光子产生的电荷信息,这其中包括了光子到 达时间信息,光子的能量、强度信息等。X 射线在与 Si-PIN 探测器介质发生相互作用时,每产生一个电子 空穴需要的平均能量值为 3.6 eV。因此,对于 5 ~ 30 keV 能区的 X 射线,在 Si-PIN 探测器中发生相互作 用之后,所产生的平均电荷数在1388~8333之间, 对应的电荷量为2.2×10⁻¹⁶~1.3×10⁻¹⁵库仑之间。而 Si-PIN 探测器自身没有电荷放大作用,因此对于读出 电子学系统来说,Si-PIN 探测器输出的信号非常小, 因此电子学系统的噪声控制就是其关键的因素。

对于 ME 的 Si-PIN 探测器来说,入射 X 射线光 子的能量正比于其在探测器介质材料中发生相互作用 所产生的平均电荷数(电子空穴对)N。因此只要准 确的读出探测器收集到的电荷量,就可以给出入射 X 射线光子的能量信息。这其中又要充分考虑噪声影 响因素,而第一级放大的作用尤其重要。因此 ME 电 子学第一级放大设计使用了低噪声且具有很好线形输 出的电荷灵敏前置放大器 (CSA)。电荷被收集到 Si-PIN 探测器的两极后,即会被电荷灵敏前置放大器收 集放大。电荷灵敏前置放大器的主要功能是探测器信 号的收集与放大。通过高倍数的放大电路(放大倍数 A>10⁴)加反馈电容 C_f(电容值 50×10⁻¹⁵ F)的电路设 计,实现由探测器收集到的电荷信号转换为电荷灵敏 前置放大器输出的电压信号。

而前置放大器输出的信号幅度还是非常小,大约 只有1mV左右,并且其脉冲信号的上升沿小于1µs。 因此前置放大器的信号如果不做处理,其代表入射 X 射线能量信息的峰值幅度就很难被后级采样电路准确 的采到。所以在前置放大器的后端,设计了成形放大 器(Shaping Amplifier),在将前放信号幅度放大的同 时,通过微分-积分(CR-RC)电路对前放信号进行 高斯成形,将上升沿变缓至>1µs。成形放大电路为线 形放大,其输出幅度正比于输入信号的幅度,因此经 过成形放大后,其输出信号仍然正比于入射到探测器 内部的 X 射线能量。成形后的信号,会通过采样电路, 读取其峰值幅度信息。再经模数转换电路(ADC)将 信号幅度信息转化为数字信号,即完成一次 X 射线事 例幅度信息的获取。

时间信息的记录则是通过快成形电路模块,触发 模块完成的。电荷灵敏前置放大器的输出信号通过快 成形电路放大,然后经触发模块后,形成触发信号。 数据处理控制模块收到触发信号后,会记录系统时间, 即事例的到达时间。

中能 X 射线望远镜, 其探测器的面积为 952cm²,





1728 个 Si-PIN 探测器像元,因此需要 1728 通道的电子 学读出通道。而空间探测卫星项目,对资源尤其是重量、 功耗等资源都有严格的限制。因此中能望远镜上述电 子学功能模块包括电荷灵敏前置放大器、成形放大器、 快成形以及采样保持电路均在专用集成电路系统 ASIC (Application Specific Integrated Circuit)内部实现。一 片 ASIC 可以实现 32 通道的 Si-PIN 探测器的信号读出。

4. 中能望远镜的主要特点

4.1 国产化的 Si-PIN 探测器

中能 X 射线望远镜所使用的 Si-PIN 探测器,由 高能所自主设计,基本上在国内工艺线完成全部的半 导体探测器工艺,并在国内厂家完成探测器的划片 与封装。其探测器耗尽电压下的漏电流在低温 -20℃ 时达到 7 pA 左右,达到国际先进水平。漏电流是 Si-PIN 探测器的主要性能指标,是其高分辨能力的保证。 若漏电流偏大,则由于漏电流的涨落所引起的波动会 在探测器的输出端产生偏大的噪声干扰信号,从而会 降低探测器系统的能量分辨率。 而 Si-PIN 探测器常温 nA 量级,低温下 pA 量级 的工作电流,使其极易受到环境因素的影响。探测器 输入端非常微弱的电磁干扰,就可能会在探测器前端 引起影响探测器性能的噪声信号。因此 ME 探测器机 箱在研制过程对仪器的电磁屏蔽作了多方面的设计与 考虑,包括机箱采用单点接地,避免仪器安装后从安 装界面带来的地干扰。整体金属化屏蔽设计不留缝隙, 避免电磁干扰等。

同时,ME 探测器为非密封封装,外界空气可以 直接接触到探测器表面,因此很容易发生探测器的表 面污染,而其表面污染所带来的表面漏电,很多时候 会远大于探测器的工作电流达到 µA 量级,从而会引 起探测器的性能变的很差而无法继续使用。在 ME 研 制过程中采取了严格的防污染控制措施,包括所有的 工艺全部在洁净工作间完成,同时尽量缩短仪器在整 体试验过程中时处在非洁净环境中的时间等。

4.2 ASIC 技术的应用

中能 X 射线望远镜,总共包括 1728 通道的读出 电子学。若采用分立器件搭建的方式构造,按照每通



图 9 ME Si-PIN 探测器实物照片(左)及漏电流随温度变化测试结果(右)



23

道1W的功耗估计,总共就需要1728W。按照每通 道读出500g估计,其总的重量将超过800kg,这对 于卫星项目来说,是不可接受的。因此,ME电子学 在设计时采用了高集成、低噪声、低功耗的ASIC技 术。采用微电子0.35μm工艺的每片ASIC芯片(5mm 尺度)便可以实现32通道的前放、慢成形、快成形、 采样保持等电路功能。而其每通道的功耗只有不到 2mW。

而 ME 所选用的 ASIC 芯片,由于其采用了低噪 声设计工艺,故部分引脚并没有进行静电防护设计, 因此其静电敏感度非常高,部分敏感引脚其静电敏感 度甚至只有几十伏。在冬天我们在脱毛衣时,所产生 的静电通常都会达到上千伏。因此不到 100V 的静电 敏感度,给该芯片的封装以及后续的印刷电路板(PCB) 电装等带来了很大的风险。ME 在研制过程中制定了 严格的静电防护措施,并且与相关的封装以及电装厂 家联合制定了详细的静电防护操作规范,保证了全过 程可控,完成了与 ASIC 相关的所有工作。

4.3 模块化设计

中能 X 射线望远镜,是个非常复杂的系统。一 个探测器机箱,就包括了 111 块 PCB 板,数据采集与 ASIC 控制程序超过 12000 行,装机元器件超过 5000 个。从1个通道到 1000 个通道,并不是简单的复制, 而是包括很多的系统性风险,其复杂程度也是指数提 高的。因此为了更好的控制风险,并提高仪器的可维 修性和可维护性,中能 X 射线望远镜采用了模块化设 计的原则。

基于 ASIC 将每 32 个通道包括探测器加读出电子 学构成一个探测器模块,模块之间的供电都是独立的 走线,并进行了有效的隔离。每6个这样的模块组成 一个探测单元,每个探测单元除探测模块外,还包括 共用的数据采集电路,包括控制用的现场可编程门阵 列(FPGA)等。每3个这样的探测单元构成一个探 测器机箱。整个中能 X 射线望远镜,被分成了3个探 测器机箱,9个探测单元,54个探测模块。模块与模 块之间,探测单元与探测单元之间,彼此独立。其中 某部分发生故障不影响其他部分的正常工作。且各模 块可单独拆卸,因此保证了整个系统的可靠性与可维 修性。

4.4 国际同类仪器对比

国际上采用 Si-PIN 探测器技术的空间探测项目, 其中部分是采用小面积单通道的 Si-PIN 探测器。比如 美国火星车上搭载的 a/X 射线谱仪(APXS),由于 采用的是单通道面积小于 10mm²的 Si-PIN 探测器, 因此可以采用自复位式前放的设计,有很高的能量分 辨率,其只用于低能区的 X 射线荧光探测。国际上与 ME 有类似科学目标,也采用阵列式 Si-PIN 探测器的 项目为日本的 Suzaku 卫星。其携带的中高能段的 X 射线探测器(HXD),也采用大面积 Si-PIN 阵列探 测技术,其探测能区在 10 ~ 70 keV,发射上天后调



整为 12 ~ 70 keV,其灵敏面积为 160cm²,能量分辨 率约在 FWHM 4 keV @59.5 keV。其发射上天后在活 动星系核 (AGN)的反射成分,天体源的时变与能谱 观测等方面获得了大量的科学产出。中能 X 射线望远 镜的主要技术指标要高于 Suzaku HXD,预期 ME 可 以得到相应的科学成果。

表1 HXMT ME 与 Suzaku HXD 主要技术指标对比

	Suzaku HXD	HXMT ME
能量分辨率	FWHM 4 keV@59.5 keV (-20°C)	FWHM 3 keV@59.5 keV (−5℃)
面积	$\sim 160~{ m cm}^2$ @20 keV	$\sim 600~{ m cm}^2$ @20 keV
探测能区	$12\sim 70~{ m keV}$	$5\sim 30~{ m keV}$

5. 小结与展望

中能 X 射线望远镜,经过多年的努力,已完成产 品的研制,并通过了全部环境模拟试验的考核,以及 大部分标定试验工作。目前已交付装配卫星,并随整 星完成了整星力学、热真空、电磁兼容(EMC)试验。 其主要性能指标均达到设计预期。

该仪器采用了完全国内自主研制的 Si-PIN 探测器,并开发使用了低噪声 ASIC 技术。相关技术在后续空间 X 射线观测,以及空间带电粒子探测等方面都 具有很好的应用前景。该仪器的研制在满足该项目科 学目标研究的需要基础之上,对于带动国内相关技术 的发展同样具有重要的实际应用意义。

科苑快讯

自其发明至今的 50 多年里,激光器已经衍生出诸 多领域的技术:从 CD 播放器到外科手术器械。

目前,法国和匈牙利的研究人员发明了一种既廉价、便捷,又高效的打印激光器的新方法,他们认为 该激光器的核心部件是一次性的。该团队将他们的研究结果发表在 AIP 出版的《应用物理杂志》(Journal of Applied Physics)上。

"我们研究工作最具价值之处就是激光器的低成本 和易于制造,"法国普罗旺斯的圣艾蒂安国立高等矿业 学校微电子中心的副教授萨瑙尔(S. Sanaur)认为。萨 瑙尔与其同事研制采用碳基材料来产生光放大的有机激 光器。我们熟悉的激光笔、DVD播放器、光电鼠标等 采用的都是无机激光器,有机激光器虽然使用还不那么 普遍,但它具有光子转换效率高、易于安装、价格低廉 以及波长范围宽等优势。制约有机激光器发展的一个障 碍是其退化失效相对较快,但如果激光器的成本特别低 廉则该问题将不复存在,因为一旦失效就可以立即丢弃。

萨瑙尔研究团队制造极低成本的有机激光器采用 的是我们非常熟悉的一项技术:喷墨打印。喷墨打印 是一项相对便宜的制造工艺,采用向基底喷射细小液 体束流的工作方式。办公室用的喷墨打印机仅是该技 术的一种应用,科学家采用该技术打印电子电路,配

一次性激光器问世

置药品,甚至组装生物细胞。"采用压电喷墨打印技术, 你可以随时随地打印",萨瑙尔说。该技术不要求佩戴 面罩,可以在室温下工作,还可以在柔性材料上打印。

研究人员测试了各种可能的喷墨,最后确定采用 一种名为 EMD6415 的商业喷墨,并将之与颜料混合, 然后在石英薄片上打印出一个个小的正方形。染料喷墨 作为激光器的核心,称为增益介质。增益介质的作用 就是光放大和产生典型狭窄、单色的激光束。激光器还 需要来回反射光,以保持光放大效应的持续进行。而这 是通过增益介质和被称为泵浦的能量源实现的。新激光 器的一次性部分是可打印的增益介质,研究人员称之为 "激光器胶囊"。他们估计其成本仅有几美分。正如剃 须刀片一样,当激光器胶囊退化失效后很容易被替换。

研究团队采用两种不同类型的染料,产生的激光 范围从黄到深红。他们预言,其他染料将覆盖光谱从 蓝到绿的部分。随着进一步的研究,并不昂贵的喷墨 激光器将有希望通过短的塑料纤维传送数据,以及作 为分析化学和生物样品的工具。

(美国物理联合会 张铮铮供稿; 绛乔编译; 论文 原文见http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/119/17/ 10.1063/1.4946826)